



FOR 即時発表

Agency Contact:

David Moreno

MCA

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com

**EBeam Initiative がムーアの法則における高集積効果の再追求に注力するための
啓蒙活動および協業促進を行う**

新たにホロン(Holon)社およびフォトロニクス(Photronics)社が eBeam Initiative に参加

SAN JOSE, Calif., February 17, 2015-電子ビーム(eBeam)技術を利用した半導体製造の新手法の普及と促進を目的したフォーラムである eBeam Initiative は本日、2015 年の主題は**ムーアの法則の高集積効果(density benefit)の eBeam 技術による再追求**であるとの声明を発表した。半導体フォトマスクおよびウエハ露光業界への、本主題による啓蒙活動および協業促進には、193-nm 液浸露光技術を用いた 10-nm ノード世代及びそれ以降での継続的な高密度化およびマスク設計における矩形制約の排除を可能とする**複雑なインパース露光技術(ILT)と組み合わせたマルチビームマスク描画**や**モデルベースのマスクデータ処理(MB-MDP)**の最新の開発状況の発表を含む。

関連ニュースとして、先端フォトマスクおよびウエハ メトロロジーのプロバイダーである株式会社ホロン(Holon Co., Ltd.)および先端半導体フォトマスク製造のフォトロニクス社(Photronics, Inc)が eBeam Initiative に加わった。「ホロン社とフォトロニクス社を eBeam コミュニティーに新メンバーとしてお迎えできることは大変喜ばしいことです。2社のユニークな考え方、協業体制と業界内でのリーダーシップが加わる事は Initiative の啓蒙目標を促進する上で誠に喜ばしい事です。」と eBeam Initiative の事務局を担う D2S の CEO Aki Fujimura 氏は述べている。

フォトロニクス社のチーフテクノロジーオフィサー(CTO)で戦略企画担当(Strategic Planning)、業界有識者の Dr. Chris Proglar 氏は、来週カリフォルニア州サンノゼ市で開かれる SPIE Advanced Lithography カンファレンスの際に開催される eBeam Initiative の年次ランチ会議の際、10-nm ロジックノードに対する彼の見解を発表する予定である。

数々のニュースソースの中で、先端フォトマスクおよび半導体製造に使われる eBeam 技術のエコシステムを形作る新たな産業開発に対する独特の見解を提供するファインラインビデオ雑誌(Fine Line Video Journal)を、eBeam Initiative は継続的に発刊する。PMC-Sierra 社の創設者でありチーフオペレーティングオフィサー(COO)である Colin Harris 氏のムーアの法則での高集積効果と現実との増大するギャップに対するファブレス半導体メーカー視点での見解に関するビデオインタビューが先行リリースされ、www.ebeaminitiative.org/にてダウンロードが可能である。

Aki Fujimura 氏は本テーマを SPIE Advanced Lithography カンファレンスの際に開催される eBeam Initiative ランチ会議の開会の辞にてハイライトする予定である。

「Colin Harris 氏が述べたように、ムーアの法則におけるワット当たりの性能がいまだに真実であるように、ルールが非常に保守的で導入コストが非常に高い従来のルールベースのデザインは、**微細なシステムオンチップ(SOC)設計での、微細化による経済効果を失わせつつあります。**」と Fujimura 氏は述べている。「マルチビームマスク描画の急速な立ち上がりと並行して、複雑な ILT、MB-MDP および既存の可変形成型ビーム(VSB)によるマスク描画と組み合わせたシミュレーションに基づくアプローチは、半導体業界にある本課題の解決を可能とし、ムーアの法則の高集積効果の追求を再始動するためのプラットフォームとなります。eBeam エコシステムが業界としてムーアの法則に貢献できる時代にいられることは本当にエキサイティングなことです。」

Colin Harris 氏のビデオおよび他の方のビデオインタビューは、3月16日に eBeam Initiative のウェブサイトに掲載されるファインラインビデオ雑誌の 2015 年春版に含まれる予定である。

About The eBeam Initiative

eBeam Initiative は電子ビーム(eBeam)技術を利用した半導体製造に対する新しい手法の普及と促進を目的としたフォーラムです。Initiative のゴールは、半導体業界のエコシステム中で eBeam 技術に対する投資を喚起しつつ、より多くの集積回路(IC)設計を可能とし、より速い商品開発期間(faster time-to-market)を実現する技術の導入を可能ならしめることにあります。 e-Beam Initiative はメンバー企業、アドバイザー、およびステアリング委員会から構成され、半導体関連の全分野の機関が参加しており、米 Abeam Technologies、株式会社アドバンテスト、台湾 Alchip Technologies、独 AMTC、米 Applied Materials、米 Artwork Conversion、仏 Asetta Nanographics、米 ケイデンス・デザイン・システムズ、仏 CEA-Leti、米 D2S 社、大日本印刷株式会社、独 EQUIcon Software GmbH Jena 社、米 eSilicon Corporation 社、米 Fastrack Design 社、独 Fraunhofer CNT 社、富士通セミコンダクター株式会社、独 GenlSys GmbH 社、米 グローバルファンドリーズ社、米 Grenon Consulting、日立ハイテクノロジーズ社、株式会社 Holon、HOYA 株式会社、独 IMS CHIPS 社、奥 IMS Nanofabrication AG 社、日本電子株式会社(JEOL)、米 KLA-Tencor 社、米 Mentor Graphics Corporation、Multibeam Corporation、日本コントロールシステム株式会社、株式会社ニューフレアテクノロジー、nVIDIA 社 John Chen 氏、米 Petersen Advanced Lithography 社、米フォトリクス社、米 PMC-Sierra 社の Colin Harris 氏、米クアルコム社の RikoRadojic 氏、米 Sage Design Automation、韓国サムスン・エレクトロニクス社、仏 STMicroelectronics 社、米 Synopsys 社、米 tau-Metrix 社、米 Tela Innovations 社、TOOL 株式会社、凸版印刷株式会社、独 Vistec Electron Beam Lithography Group、米 Xilinx 社 Hugh Durdan 氏 が含まれます。また、本イニシアティブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。詳しくは URL: www.ebeaminitiative.org/ を参照ください。

###